

Title (en)

Modular control apparatus for control and automatic systems

Title (de)

Modulare Steuerungsanlage für Steuerungs- und Automatisierungssysteme

Title (fr)

Installation de contrôle modulaire pour des systèmes de contrôle et de réglage

Publication

EP 1251595 A1 20021023 (DE)

Application

EP 01109714 A 20010420

Priority

EP 01109714 A 20010420

Abstract (en)

The system consists of modular individual components such as input or output modules (10), control units or similar connected to a voltage supply (1) and a field bus (2). An individual component is arranged in a stand-alone self-supporting individual component housing with a cable connection to an external element, e.g. an actuator, and mechanical and electrical connections to other component housings.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine modulare Steuerungsanlage für Steuerungs- und Automatisierungssysteme, aus modularen Einzelkomponenten wie Eingangsmodulen (10), Ausgangsmodulen (10), Steuerungseinheiten (11) und dgl.. Die Einzelkomponenten sind mit einer Spannungsversorgung (1) sowie einem Feldbus (2) für Daten und Steuerungsbefehle verbunden. Um eine freie Zusammenstellung der verschiedenen Einzelkomponenten zu ermöglichen, ist vorgesehen, daß eine Einzelkomponente (10, 11, 12) in einem selbständigen, selbsttragenden Einzelkomponentengehäuse (5) angeordnet ist, wobei das Einzelkomponentengehäuse (5) einen Leitungsanschluß (6) zur Verbindung mit einem äußeren Systemelement, wie z.B. einem Aktor, einem Sensor oder dgl., aufweist. Jedes Einzelkomponentengehäuse (5) hat einen mechanischen Anschluß (8) zur verkettenden, mechanischen Befestigung an einem weiteren Einzelkomponentengehäuse (5) sowie eine elektrische Anschlußleiste (20) zur elektrischen Verbindung mit einer Kontaktleiste (21) des weiteren Einzelkomponentengehäuses (5). <IMAGE>

IPC 1-7

H01R 13/514; **H01R 13/66**

IPC 8 full level

H01R 13/514 (2006.01); **H01R 13/66** (2006.01); **H01R 9/24** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01R 13/514 (2013.01); **H01R 13/665** (2013.01); **H01R 9/2458** (2013.01); **H01R 9/2491** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] DE 2415727 A1 19751009 - BRANDI ENTWICKLUNGS GMBH
- [A] US 6111772 A 20000829 - LEE CHIU-SHAN [TW], et al
- [A] DE 19845311 A1 19990422 - YAZAKI CORP [JP]

Cited by

CN109586050A; EP3078080A4; DE102006051280C5; DE102006051281C5; CN116587256A; DE202004011880U1; CN107317157A; EP1696518A1; USRE48517E; WO2015084246A1; WO2018109124A1; DE102016116127A1; US10122126B2; EP2183751A4; EP2642602A1; EP2642603A1; EP3441984A1; US7341483B2; US10806047B2; EP2244335B1; EP2642602B1

Designated contracting state (EPC)

DE FR IT

DOCDB simple family (publication)

EP 1251595 A1 20021023; **EP 1251595 B1 20040811**; AT E268508 T1 20040615; DE 50103214 D1 20040916; DE 50200491 D1 20040708

DOCDB simple family (application)

EP 01109714 A 20010420; AT 02008928 T 20020422; DE 50103214 T 20010420; DE 50200491 T 20020422